

EasyFairs Packaging Innovations se celebra junto con EasyFairs Labelling Innovations

La tercera edición de easyFairs Packaging Innovations Barcelona 2010, el Salón Internacional de Tendencias en Packaging de Alto Valor Añadido, tendrá lugar en el CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona los días 14 y 15 de abril. En esta ocasión, la novedad radica en que se celebrará paralelamente con easyFairs Labelling Innovations Barcelona 2010, el Salón Internacional del Etiquetado, Codificación, Trazabilidad e Impresión del sur de Europa.

Más de 150 expositores, al menos un 20% de ellos internacionales, mostrarán los últimos avances en diseño gráfico e industrial, branding y gestión de marca, transformación de materiales, ecopackaging, PLV, embalaje publicitario y promocional, servicios de impresión y packaging inteligente, en el caso de easyFairs Packaging Innovations. En el salón de easyFairs Labelling Innovations, se presentarán las novedades en etiquetado, tecnología de pre-impresión y producción, codificación, trazabilidad, procesos y maquinaria de impresión, nuevos materiales, RFID, soluciones de seguridad y adhesivos y tintas.

Una cartera de salones innovadores

La próxima edición del Salón easyFairs Packaging Innovations Barcelona presentará numerosas novedades. No sólo por parte de los expositores, sino también por la inclusión de nuevas áreas con identidad propia. La primera es la denominada Zona Design in Italy, en la que se mostrará las novedades en exclusiva de diseñadores de packaging de toda Italia. La segunda es el Área World Design, un espacio de inspiración donde descubrir ideas de todos los rincones del mundo. Además, durante el salón se presentará el Informe de Tendencias del Packaging de Diseño, realizado por easyFairs, en el que se desarrollará las tendencias del consumo de packaging de diseño.

Paralelamente, los visitantes podrán asistir al triple ciclo de Seminarios Independientes learnShops gratuitos. En el salón easyFairs Packaging Innovations se realizarán dos de los ciclos, que tratarán temas sobre packaging especializados en el área de Ecopack, coorganizados con ITENE -Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, y de Brandpack. En el salón easyFairs Labelling Innovations, por su parte, tendrá lugar el tercer ciclo y estará enfocado a RFID, coding y labelling.